

Das Konzept des Digitalen Zwillings in der Cu-Galvanik – Verbesserte Prozesskontrolle und Metalloberflächenbehandlung für die Leiterplattenherstellung



Die galvanische Verkupferung spielt bei der Herstellung von Leiterplatten eine entscheidende Rolle. Ihr Hauptvorteil ist die Reduzierung der Impedanz der Leitung und des Spannungsabfalls. Die Prozessleistung wirkt sich direkt auf die Qualität der Kupferschicht und die damit verbundenen mechanischen Eigenschaften aus: Bei der sauren Verkupferung besteht die Herausforderung darin, eine angemessene Schichtdickenverteilung und Oberflächengleichmäßigkeit zu erreichen, ohne dabei die metallurgischen Eigenschaften wie die prozentuale Dehnung und die Zugfestigkeit der Abscheidung übermäßig zu beeinträchtigen. Eine Verringerung der Stromdichte kann die Kupferdicke bis zu einem gewissen Grad ausgleichen, führt aber zu einer übermäßigen Verlängerung der Gesamtbeschichtungszeit, was den Durchsatz von Leiterplatten drastisch beeinträchtigt. Daher ist die ordnungsgemäße Kontrolle der Prozessleistung und folglich der Qualität der galvanischen Kupferschicht ein wichtiger Bestandteil der Leiterplattenbeschichtungstechnik, die selbst für relativ erfahrene Leiterplattenfabriken eine der größten Herausforderungen darstellt.

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

Preis inkl. Preisnachlass: 4,39 €

4,70 €

Netto-Preis: 4,39 €

Enthaltene MwSt.: 0,31 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)